

证券代码：301717

证券简称：超纯应材

公告编号：2026-010

成都超纯应用材料股份有限公司

关于公司实施募集资金补充流动资金项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司实施募集资金补充流动资金项目的议案》，为满足经营规模日益扩大带来的资金需求，促进主营业务的稳定和公司的健康持续发展，拟将公司首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币12,000.00万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1207号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,461,539股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币65.99元/股，募集资金总额为人民币1,680,206,958.61元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,557,191,397.28元。

上述募集资金已于2026年8月6日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕11-26号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	半导体设备核心光学零部件产业化项目	34,895.00	34,895.00
2	半导体材料及表面处理产业化项目	31,737.00	31,737.00
3	眉山基地产能扩建项目	20,900.00	17,780.00
4	总部及研发中心建设项目	16,056.00	16,056.00
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		115,588.00	112,468.00

注：本次发行募集资金总额为人民币168,020.70万元，扣除不含增值税发行费用人民币12,301.56万元，实际募集资金净额为人民币155,719.14万元，超募金额43,251.14万元。

三、补充流动资金项目实施

根据公司生产经营需要以及公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，拟将募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币 12,000.00 万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

本次募投项目“补充流动资金”的实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，“补充流动资金”项目实施能够有效满足公司主营业务的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次事项履行的决策程序

公司于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司将募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币12,000.00万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

五、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司

董事会

2026年9月11日